**企业技术难题及合作意向表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 中芯国际 | | |
| **详细地址** | 北京经济技术开发区文昌大道18号 | | |
| **意向合作中科院单位** | |  | |
| **所属产业类别** | □新一代信息技术产业 □新能源汽车与智能网联汽车产业 □生物技术与大健康产业 □机器人与智能制造产业 √其他，请说明 集成电路 | | |
| **企业简介** | 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。 | | |
| **技术需求** | **技术需求名称** | | **需求详情、技术基础及合作意向** |
| RTP标准片材质确认及开发 | | 标准片上特有的镀层材质需要分析，镀层加工工艺需要开发。 |
| **预期取得的主要成果和效益** | 镀层成分分析，在国内没有能够借鉴经验的前提下，通过其工作原理进行辅助判断。实现加工完全国产，打破国外垄断。 | | |
| **希望政府部门协调解决的问题和相关建议** | 标准片上特有的镀层材质需要分析，镀层加工工艺需要开发。 | | |